

2025-2031年中国半导体设备行业发展态势与投资前景预测报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2025-2031年中国半导体设备行业发展态势与投资前景预测报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202503/480105.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

中企顾问网发布的《2025-2031年中国半导体设备行业发展态势与投资前景预测报告》共十四章。首先介绍了半导体设备行业基本概述，接着分析了中国半导体设备行业发展环境及半导体行业产业链的发展状况。然后对半导体设备行业进行了全面分析。接着，报告具体介绍了半导体光刻、刻蚀、清洗及测试设备的市场状况。然后报告分析了国内外重点半导体设备企业经营状况。最后，报告对半导体设备行业进行了投资分析并对行业未来发展前景进行了科学的预测。

本研究报告数据主要来自于国家统计局、商务部、工信部、中国海关总署、中企顾问网、中企顾问网市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对半导体设备行业有个系统深入的了解、或者想投资半导体设备行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。

。

报告目录：

第一章 半导体设备行业基本概述

1.1 半导体的定义和分类

1.1.1 半导体的定义

1.1.2 半导体的分类

1.1.3 半导体的应用

1.2 半导体设备行业概述

1.2.1 行业概念界定

1.2.2 行业主要分类

第二章 2020-2024年中国半导体设备行业发展环境PEST分析

2.1 政策环境（Political）

2.1.1 行业主管部门与监管体制

2.1.2 半导体设备政策汇总

2.1.3 半导体制造利好政策

2.1.4 集成电路企业税收优惠

2.1.5 集成电路产业政策扶持

2.1.6 产业投资基金的支持

2.2 经济环境（Economic）

2.2.1 宏观经济发展概况

2.2.2 工业经济运行情况

2.2.3 固定资产投资状况

2.2.4 未来经济发展展望

2.3 社会环境 (Social)

2.3.1 电子信息产业增速

2.3.2 电子产品消费情况

2.3.3 新能源汽车销售情况

2.3.4 研发经费投入增长

2.3.5 科技人才队伍壮大

2.4 技术环境 (Technological)

2.4.1 企业研发投入

2.4.2 技术迭代历程

2.4.3 企业专利状况

第三章 2020-2024年半导体产业链发展状况

3.1 半导体产业链分析

3.1.1 半导体产业链结构

3.1.2 半导体产业链流程

3.1.3 半导体产业链转移

3.2 2020-2024年全球半导体市场总体分析

3.2.1 市场销售规模

3.2.2 行业产品结构

3.2.3 区域市场格局

3.2.4 产业研发投入

3.2.5 市场竞争状况

3.2.6 企业支出状况

3.2.7 产业发展前景

3.3 2020-2024年中国半导体市场运行状况

3.3.1 产业发展历程

3.3.2 产业销售规模

3.3.3 市场结构分布

3.3.4 产业贸易情况

3.3.5 产业区域分布

3.3.6 市场机会分析

3.4 2020-2024中国IC设计行业发展分析

3.4.1 行业发展历程

3.4.2 行业发展优势

3.4.3 市场发展规模

3.4.4 企业发展状况

3.4.5 产业地域分布

3.4.6 专利申请情况

3.4.7 资本市场表现

3.4.8 行业面临挑战

3.4.9 行业发展建议

3.5 2020-2024年中国IC制造行业发展分析

3.5.1 制造工艺分析

3.5.2 晶圆加工技术

3.5.3 市场发展规模

3.5.4 企业排名状况

3.5.5 行业发展措施

3.6 2020-2024年中国IC封装测试行业发展分析

3.6.1 封装基本介绍

3.6.2 封装技术趋势

3.6.3 芯片测试原理

3.6.4 市场发展规模

3.6.5 芯片测试分类

3.6.6 企业排名状况

3.6.7 技术发展趋势

第四章 2020-2024年半导体设备行业发展综合分析

4.1 2020-2024年全球半导体设备市场发展形势

4.1.1 市场销售规模

4.1.2 市场结构分析

4.1.3 市场区域分布

4.1.4 市场竞争格局

4.1.5 重点厂商介绍

4.1.6 市场规模预测

4.2 2020-2024年中国半导体设备市场发展状况

4.2.1 市场销售规模

4.2.2 市场需求分析

4.2.3 企业竞争态势

4.2.4 企业产品布局

4.2.5 企业招标情况

4.2.6 市场国产化率

4.3 半导体产业核心设备——晶圆制造设备市场运行分析

4.3.1 设备基本概述

4.3.2 市场发展规模

4.3.3 市场结构占比

4.3.4 核心环节分析

4.3.5 区域竞争格局

4.3.6 主要厂商介绍

4.4 半导体产业核心设备——晶圆加工设备市场运行分析

4.4.1 设备基本概述

4.4.2 市场发展规模

4.4.3 市场价值构成

4.4.4 市场结构分析

第五章 2020-2024年半导体光刻设备市场发展分析

5.1 半导体光刻环节基本概述

5.1.1 光刻工艺重要性

5.1.2 光刻工艺的原理

5.1.3 光刻工艺的流程

5.2 半导体光刻技术发展分析

5.2.1 光刻技术原理

5.2.2 光刻技术历程

5.2.3 光学光刻技术

5.2.4 EUV光刻技术

5.2.5 X射线光刻技术

5.2.6 纳米压印光刻技术

5.3 2020-2024年光刻机市场发展综述

5.3.1 光刻机工作原理

5.3.2 光刻机发展历程

5.3.3 光刻机产业链条

5.3.4 光刻机市场规模

5.3.5 光刻机竞争格局

5.3.6 光刻机技术差距

5.4 光刻设备核心产品——EUV光刻机市场状况

5.4.1 EUV光刻机基本介绍

5.4.2 典型企业经营状况

5.4.3 EUV光刻机需求企业

5.4.4 EUV光刻机研发分析

第六章 2020-2024年半导体刻蚀设备市场发展分析

6.1 半导体刻蚀环节基本概述

6.1.1 刻蚀工艺介绍

6.1.2 刻蚀工艺分类

6.1.3 刻蚀工艺参数

6.2 干法刻蚀工艺发展优势分析

6.2.1 干法刻蚀优点分析

6.2.2 干法刻蚀应用分类

6.2.3 干法刻蚀技术演进

6.3 2020-2024年全球半导体刻蚀设备市场发展状况

6.3.1 市场发展规模

6.3.2 细分市场结构

6.3.3 市场竞争格局

6.3.4 设备研发支出

6.4 2020-2024年中国半导体刻蚀设备市场发展状况

6.4.1 市场发展规模

6.4.2 市场分布结构

6.4.3 企业发展现状

6.4.4 市场需求状况

6.4.5 市场发展机遇

第七章 2020-2024年半导体清洗设备市场发展分析

7.1 半导体清洗环节基本概述

7.1.1 清洗环节的重要性

7.1.2 清洗工艺类型比较

7.1.3 清洗设备技术原理

7.1.4 清洗设备主要类型

7.1.5 清洗设备主要部件

7.2 2020-2024年半导体清洗设备市场发展状况

7.2.1 市场发展规模

7.2.2 市场竞争格局

7.2.3 市场发展机遇

7.2.4 市场发展趋势

7.3 半导体清洗机领先企业布局状况

7.3.1 迪恩士公司

7.3.2 盛美半导体

7.3.3 至纯科技公司

7.3.4 国产化布局

第八章 2020-2024年半导体测试设备市场发展分析

8.1 半导体测试环节基本概述

8.1.1 测试流程介绍

8.1.2 前道工艺检测

8.1.3 中后道的测试

8.2 2020-2024年半导体测试设备市场发展状况

8.2.1 市场发展规模

8.2.2 市场竞争格局

8.2.3 细分市场结构

8.2.4 设备制造厂商

8.2.5 主要产品介绍

8.2.6 招投标情况

8.3 半导体测试设备重点企业发展启示

8.3.1 泰瑞达

8.3.2 爱德万

8.4 半导体测试核心设备发展分析

8.4.1 测试机

8.4.2 分选机

8.4.3 探针台

第九章 2020-2024年半导体产业其他设备市场发展分析

9.1 单晶炉设备

9.1.1 设备基本概述

9.1.2 设备数量规模

9.1.3 企业竞争格局

9.2 氧化/扩散设备

9.2.1 设备基本概述

9.2.2 市场发展现状

9.2.3 企业竞争格局

9.2.4 核心产品介绍

9.3 薄膜沉积设备

9.3.1 设备基本概述

9.3.2 市场发展现状

9.3.3 企业竞争格局

9.3.4 设备招投标情况

9.3.5 市场前景展望

9.4 化学机械抛光设备

9.4.1 设备基本概述

9.4.2 市场发展规模

9.4.3 主要企业分析

9.4.4 设备招投标情况

9.4.5 市场前景展望

第十章 2020-2024年国外半导体设备重点企业经营状况

10.1 应用材料公司（AppliedMaterials,Inc.）

10.1.1 企业发展概况

10.1.2 企业发展历程

10.1.3 企业核心产品

10.1.4 2024财年企业经营状况分析

- 10.1.5 2024财年企业经营状况分析
- 10.1.6 2024财年企业经营状况分析
- 10.1.7 企业发展前景
- 10.2 泛林集团 (LamResearchCorp.)
 - 10.2.1 企业发展概况
 - 10.2.2 企业核心产品
 - 10.2.3 2024财年企业经营状况分析
 - 10.2.4 2024财年企业经营状况分析
 - 10.2.5 2024财年企业经营状况分析
 - 10.2.6 企业发展前景
- 10.3 阿斯麦公司 (ASMLHoldingNV)
 - 10.3.1 企业发展概况
 - 10.3.2 企业发展历程
 - 10.3.3 企业核心产品
 - 10.3.4 2024财年企业经营状况分析
 - 10.3.5 2024财年企业经营状况分析
 - 10.3.6 2024财年企业经营状况分析
 - 10.3.7 企业发展前景
- 10.4 东京电子 (TokyoElectron,TEL)
 - 10.4.1 企业发展概况
 - 10.4.2 企业核心产品
 - 10.4.3 2024财年企业经营状况分析
 - 10.4.4 2024财年企业经营状况分析
 - 10.4.5 2024财年企业经营状况分析
 - 10.4.6 企业发展前景

第十一章 国内半导体设备重点企业经营状况分析

- 11.1 浙江晶盛机电股份有限公司
 - 11.1.1 企业发展概况
 - 11.1.2 经营效益分析
 - 11.1.3 业务经营分析
 - 11.1.4 财务状况分析
 - 11.1.5 核心竞争力分析

- 11.1.6 公司发展战略
- 11.1.7 未来前景展望
- 11.2 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
 - 11.2.1 企业发展概况
 - 11.2.2 经营效益分析
 - 11.2.3 业务经营分析
 - 11.2.4 财务状况分析
 - 11.2.5 核心竞争力分析
 - 11.2.6 公司发展战略
- 11.3 中微半导体设备（上海）股份有限公司
 - 11.3.1 企业发展概况
 - 11.3.2 主要产品进展
 - 11.3.3 经营效益分析
 - 11.3.4 业务经营分析
 - 11.3.5 财务状况分析
 - 11.3.6 核心竞争力分析
 - 11.3.7 公司发展战略
 - 11.3.8 未来前景展望
- 11.4 北方华创科技集团股份有限公司
 - 11.4.1 企业发展概况
 - 11.4.2 经营效益分析
 - 11.4.3 业务经营分析
 - 11.4.4 财务状况分析
 - 11.4.5 核心竞争力分析
 - 11.4.6 未来前景展望
- 11.5 沈阳芯源微电子设备股份有限公司
 - 11.5.1 企业发展概况
 - 11.5.2 经营效益分析
 - 11.5.3 业务经营分析
 - 11.5.4 财务状况分析
 - 11.5.5 核心竞争力分析
 - 11.5.6 公司发展战略

11.5.7 未来前景展望

11.6 北京华峰测控技术股份有限公司

11.6.1 企业发展概况

11.6.2 经营效益分析

11.6.3 业务经营分析

11.6.4 财务状况分析

11.6.5 核心竞争力分析

11.6.6 公司发展战略

11.6.7 未来前景展望

11.7 中电科电子

11.7.1 企业发展概况

11.7.2 企业核心产品

11.7.3 企业参与项目

11.7.4 产品研发动态

11.7.5 企业发展前景

11.8 上海微电子

11.8.1 企业发展概况

11.8.2 企业发展历程

11.8.3 企业参与项目

11.8.4 企业创新能力

11.8.5 企业发展地位

第十二章 半导体设备行业投资价值分析

12.1 半导体设备企业并购市场发展状况

12.1.1 企业并购历史回顾

12.1.2 行业并购特征分析

12.1.3 企业并购动机归因

12.1.4 行业企业并购动态

12.2 中国半导体设备市场投资机遇分析

12.2.1 整体投资机遇分析

12.2.2 晶圆厂投资需求

12.2.3 产业政策扶持发展

12.3 半导体设备行业投资机会点分析

- 12.3.1 薄膜工艺设备
- 12.3.2 刻蚀工艺设备
- 12.3.3 光刻工艺设备
- 12.3.4 清洗工艺设备
- 12.4 半导体设备行业投资壁垒分析
 - 12.4.1 技术壁垒分析
 - 12.4.2 客户验证壁垒
 - 12.4.3 竞争壁垒分析
 - 12.4.4 资金壁垒分析
- 12.5 半导体设备行业投资风险分析
 - 12.5.1 经营风险分析
 - 12.5.2 行业风险分析
 - 12.5.3 宏观环境风险
 - 12.5.4 知识产权风险
 - 12.5.5 人才资源风险
 - 12.5.6 技术研发风险
- 12.6 半导体设备投资价值评估及建议
 - 12.6.1 投资价值综合评估
 - 12.6.2 行业投资特点分析
 - 12.6.3 行业投资策略建议

第十三章 中国半导体设备行业标杆企业项目投资建设案例深度解析

- 13.1 先进半导体设备的技术研发与改进项目
 - 13.1.1 项目基本概述
 - 13.1.2 项目必要性
 - 13.1.3 项目可行性
 - 13.1.4 项目投资概算
 - 13.1.5 项目建设规划和进度
- 13.2 半导体设备研发与制造中心项目
 - 13.2.1 项目基本概述
 - 13.2.2 项目可行性
 - 13.2.3 资金需求测算
 - 13.2.4 实施进度安排

13.3 探针台研发及产业基地建设项目

13.3.1 项目基本概述

13.3.2 资金需求测算

13.3.3 建设内容规划

13.3.4 实施进度安排

13.3.5 经济效益分析

13.4 高端晶圆处理设备产业化项目

13.4.1 项目基本概述

13.4.2 资金需求测算

13.4.3 建设内容规划

13.4.4 实施进度安排

13.4.5 经济效益分析

第十四章 2025-2031年中国半导体设备行业发展趋势及预测分析

14.1 中国半导体产业未来发展趋势

14.1.1 技术发展利好

14.1.2 自主创新发展

14.1.3 产业地位提升

14.1.4 市场应用前景

14.2 中国半导体设备行业发展前景展望

14.2.1 政策支持发展

14.2.2 行业发展机遇

14.2.3 市场应用需求

14.2.4 行业发展前景

14.3 2025-2031年中国半导体设备行业预测分析

14.3.1 2025-2031年中国半导体设备行业影响因素分析

14.3.2 2025-2031年中国半导体设备销售规模预测

图表目录

图表1 半导体分类结构图

图表2 半导体分类

图表3 半导体分类及应用

图表4 半导体设备构成

图表5 IC芯片制造核心工艺主要设备全景图

- 图表6 中国半导体设备行业相关政策汇总
- 图表7 《中国制造2024》半导体产业政策目标与政策支持
- 图表8 2025-2031年IC产业政策目标与发展重点
- 图表9 一期大基金投资各领域份额占比
- 图表10 国家集成电路产业基金二期出资方（一）
- 图表11 国家集成电路产业基金二期出资方（二）
- 图表12 国家集成电路产业投资基金二期投资方向
- 图表13 2020-2024年生产总值及其增长速度
- 图表14 2020-2024年三次产业增加值占生产总值比重
- 图表15 2020-2024年全员劳动生产率
- 图表16 2024年GDP初步核算数据
- 图表17 2020-2024年GDP同比增长速度
- 图表18 2024年GDP环比增长速度
- 图表19 2020-2024年全部工业增加值及其增长速度
- 图表20 2024年主要工业产品产量及其增长速度
- 图表21 2020-2024年全部工业增加值及其增长速度
- 图表22 2024年主要工业产品产量及其增长速度
- 图表23 2020-2024年规模以上工业增加值同比增长速度
- 图表24 2024年规模以上工业生产主要数据
- 图表25 2024年三次产业投资占固定资产投资比重（不含农户）
- 图表26 2024年分行业固定资产投资（不含农户）增长速度
- 图表27 2024年固定资产投资新增主要生产与运营能力
- 图表28 2024年三次产业投资占固定资产投资比重（不含农户）
- 图表29 2024年分行业固定资产投资（不含农户）增长速度
- 图表30 2024年固定资产投资新增主要生产与运营能力

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202503/480105.html>